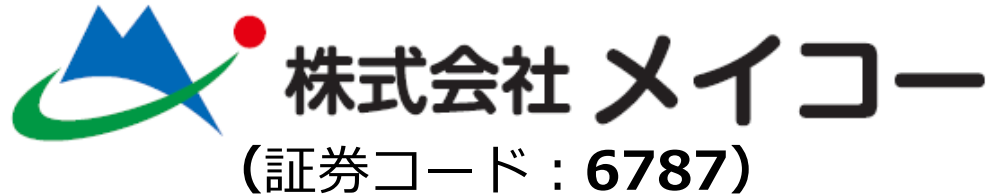


2020年度上期

決算説明会資料

2020年11月12日



注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、新型コロナウイルス等の感染症を含め、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

1

上期実績/下期予想

2

今後の方針

3

技術ロードマップ

2020年度 上期 連結実績/通期予想

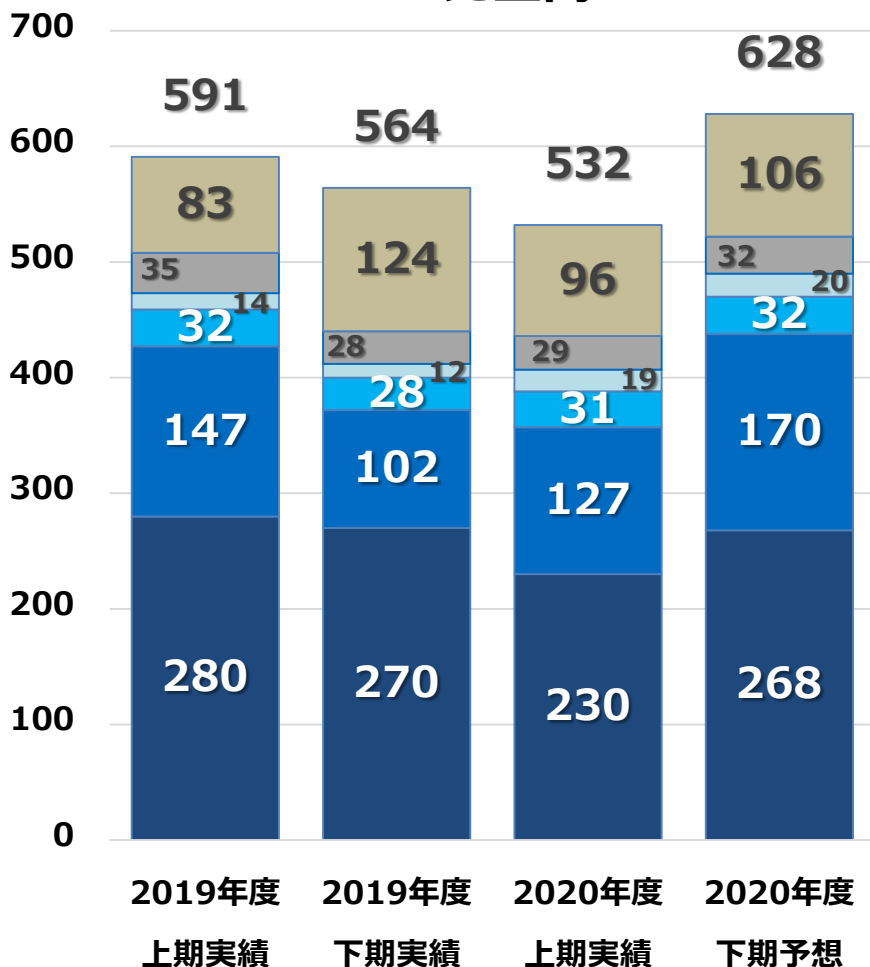
(単位：億円)

	2019年度 上期実績	2020年度 上期実績	前年同期比		2020年度 下期予想	2020年度 通期予想
			増減額	増減率		
売上高	591	532	-59	-10.0%	628	1,160
営業利益	34 5.8%	18 3.4%	-16	-46.8%	35 5.6%	53 4.6%
経常利益	30 5.1%	6 1.1%	-24	-81.5%	29 4.6%	35 3.0%
当期純利益	24 4.0%	2 0.4%	-22	-91.8%	25 4.0%	27 2.3%
期中平均為替レート (JPY/USD)	108.66	106.30			106.00	106.15
1株当たり配当金	15円	0円			20円	20円

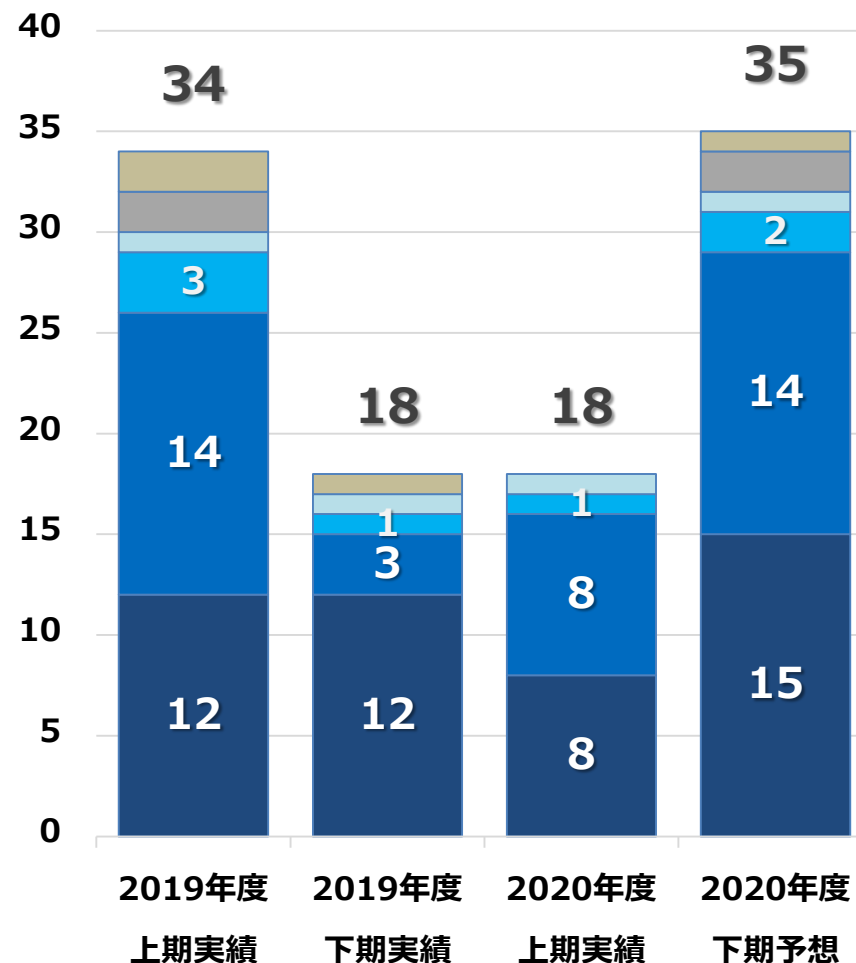
商品別売上高／営業利益の半期推移

(単位：億円)

売上高

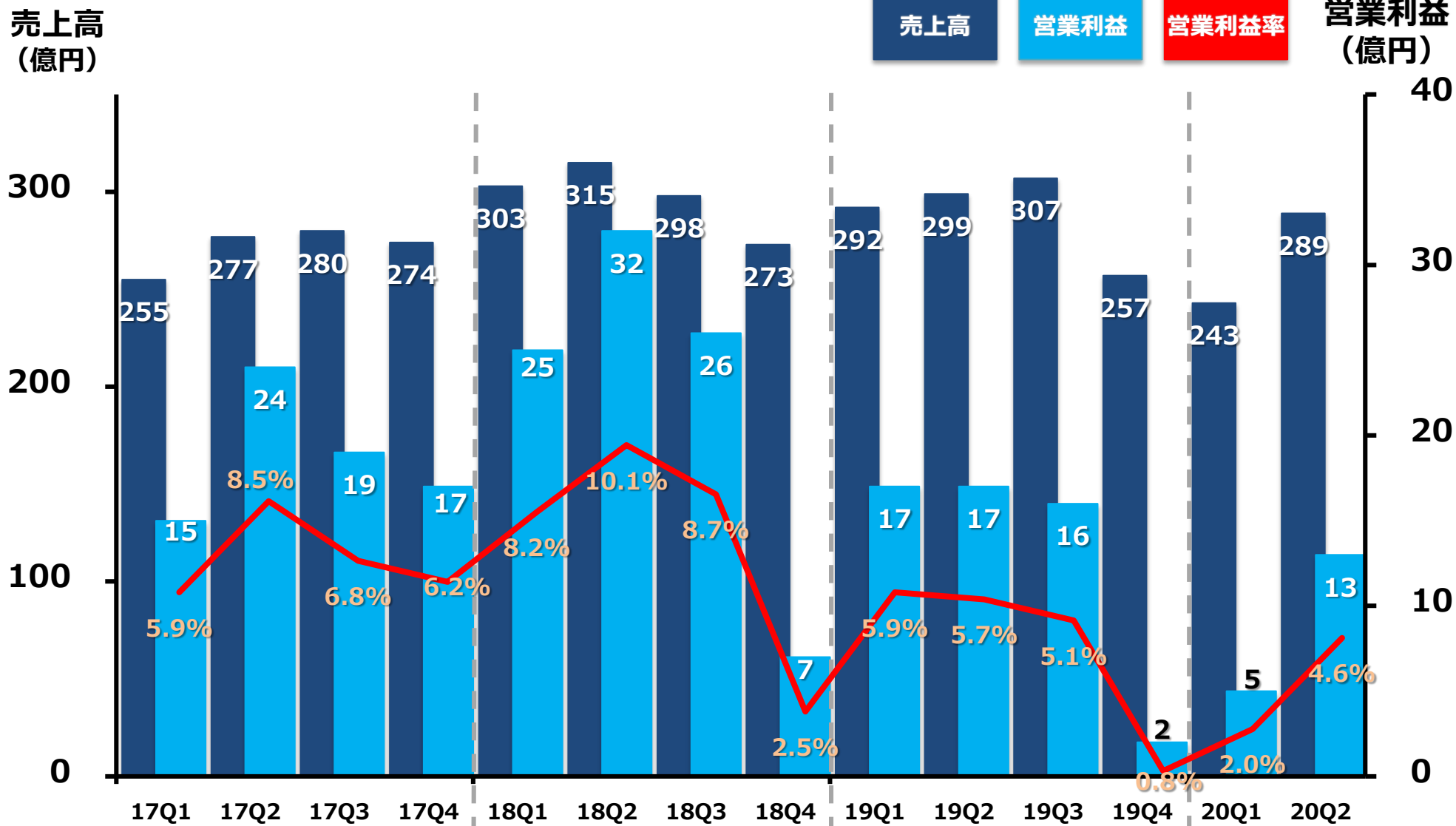


営業利益



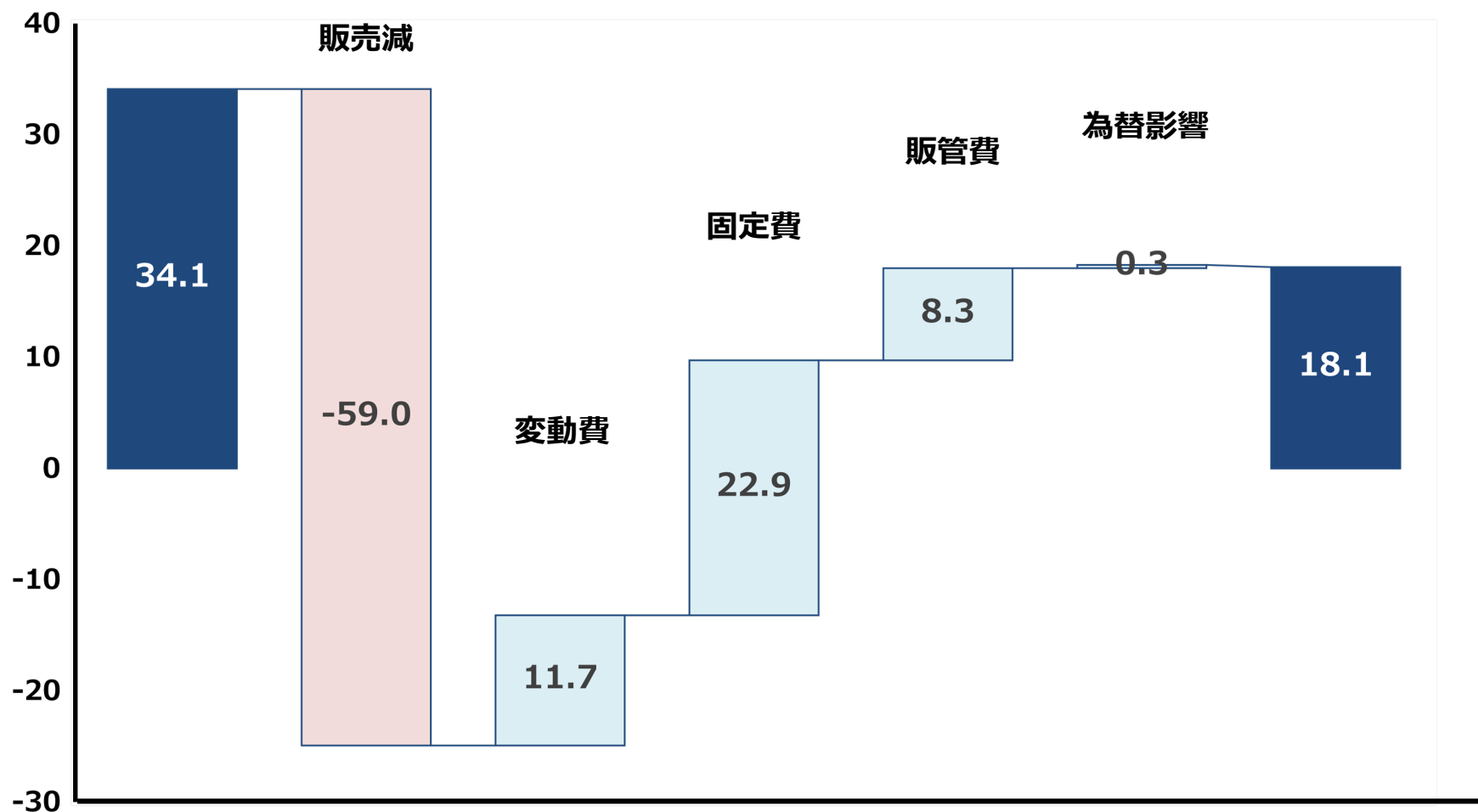
■ 車載
 ■ スマホ/タブレット
 ■ AI家電/IoT
 ■ アミューズメント
 ■ ストレージ
 ■ その他商品

売上高と営業利益の四半期推移



營業利益增減分析 ~ 2019年度上期→2020年度上期

(單位：億圓)



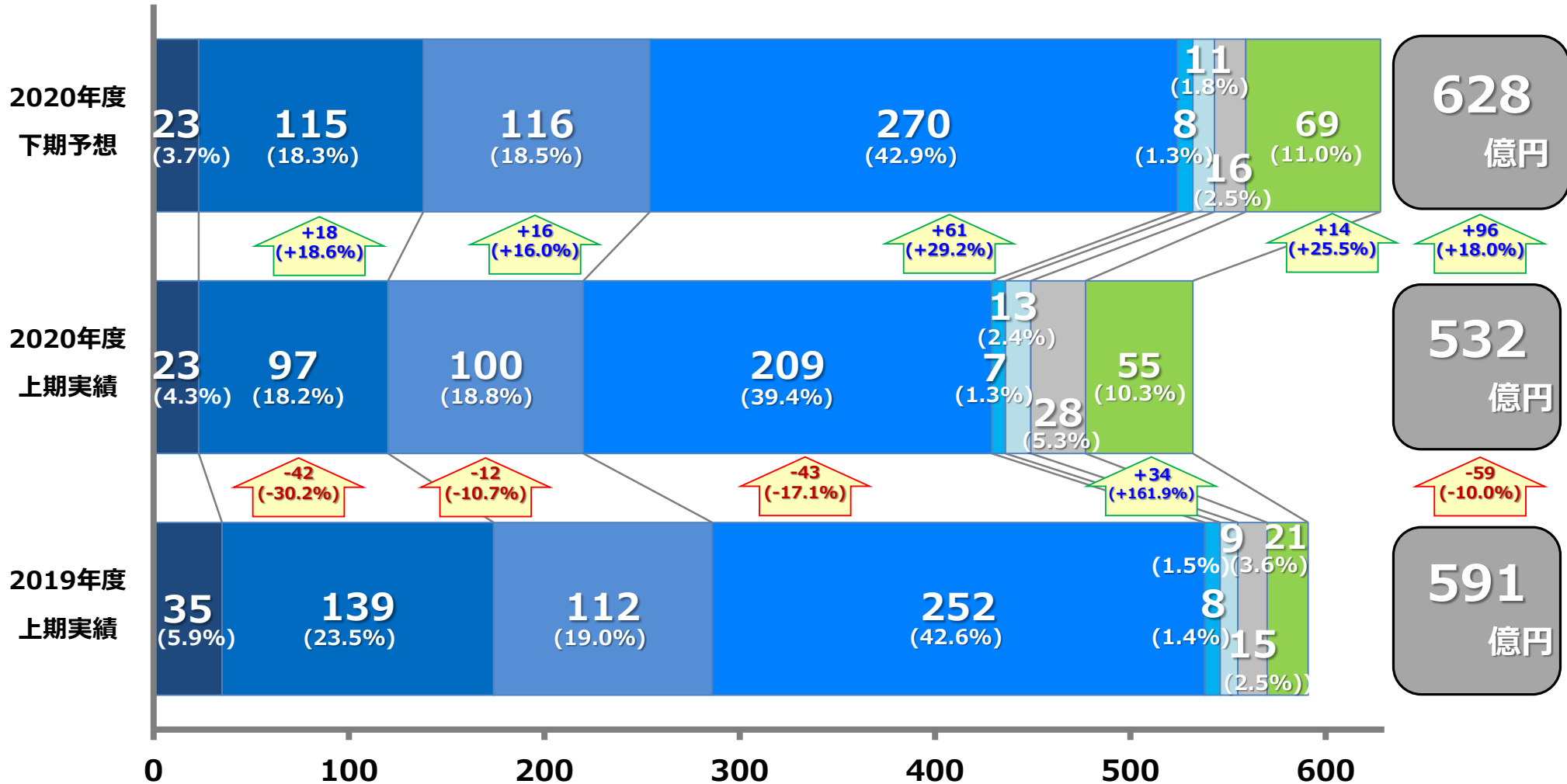
2019年度上期營業利益
為替 108.66円/US\$

2020年度上期營業利益
為替 106.30円/US\$

2020年度上期 仕様別販売実績/下期予想

(単位：億円)

■ 両面板 ■ 4層板 ■ 6層板以上 ■ ビルドアップ ■ 放熱基板 ■ フレキ ■ その他 ■ EMS



1

上期実績/下期予想

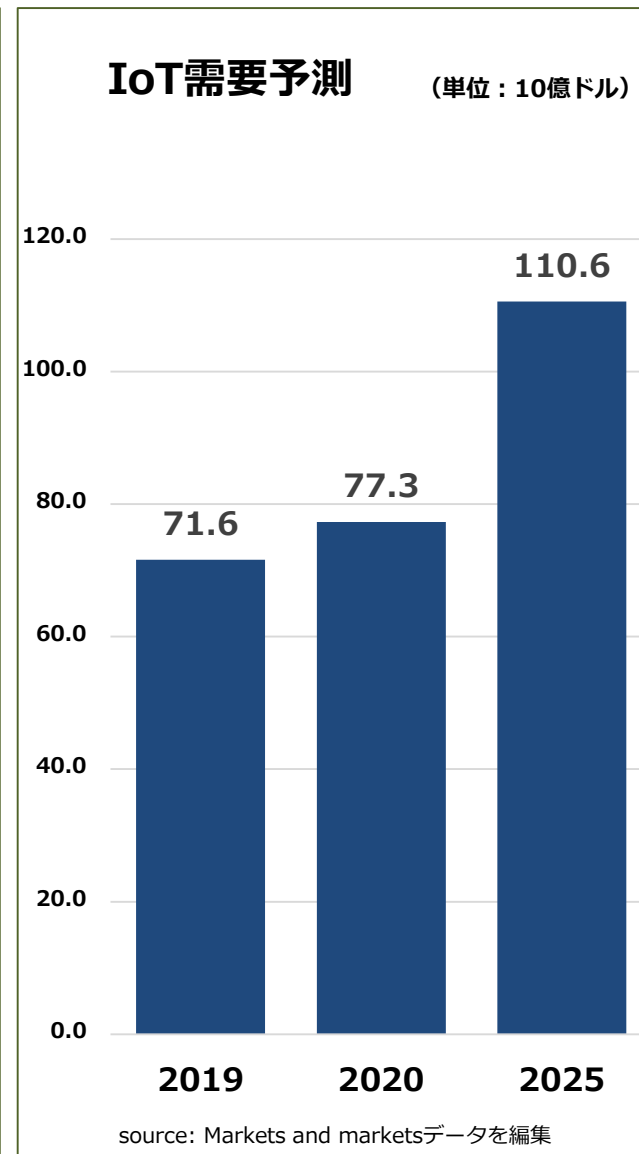
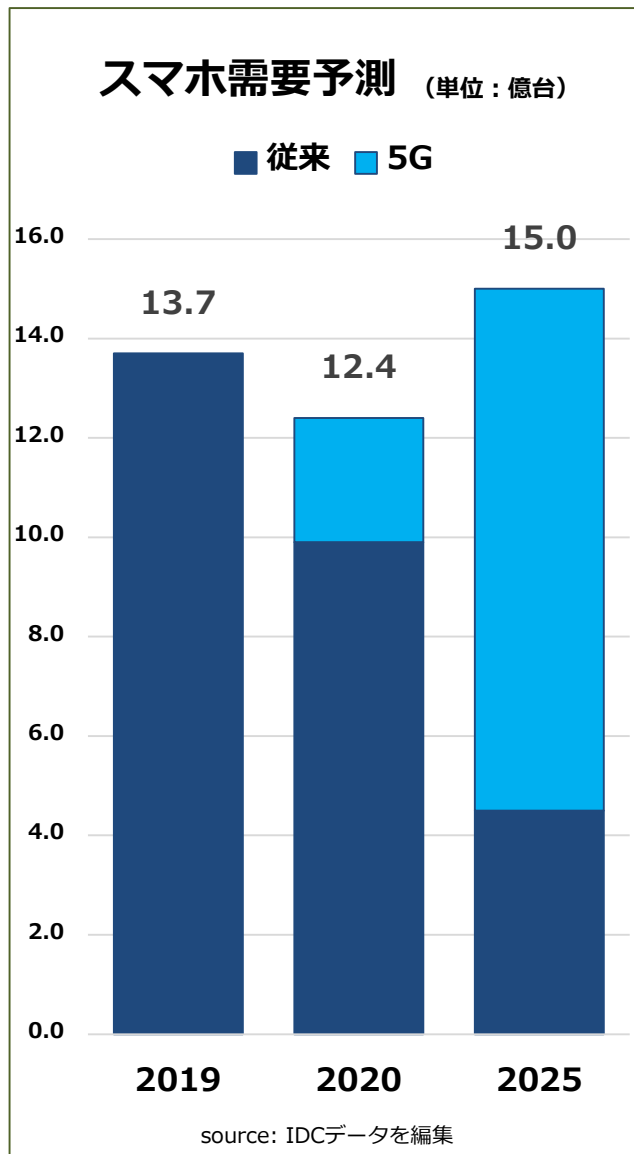
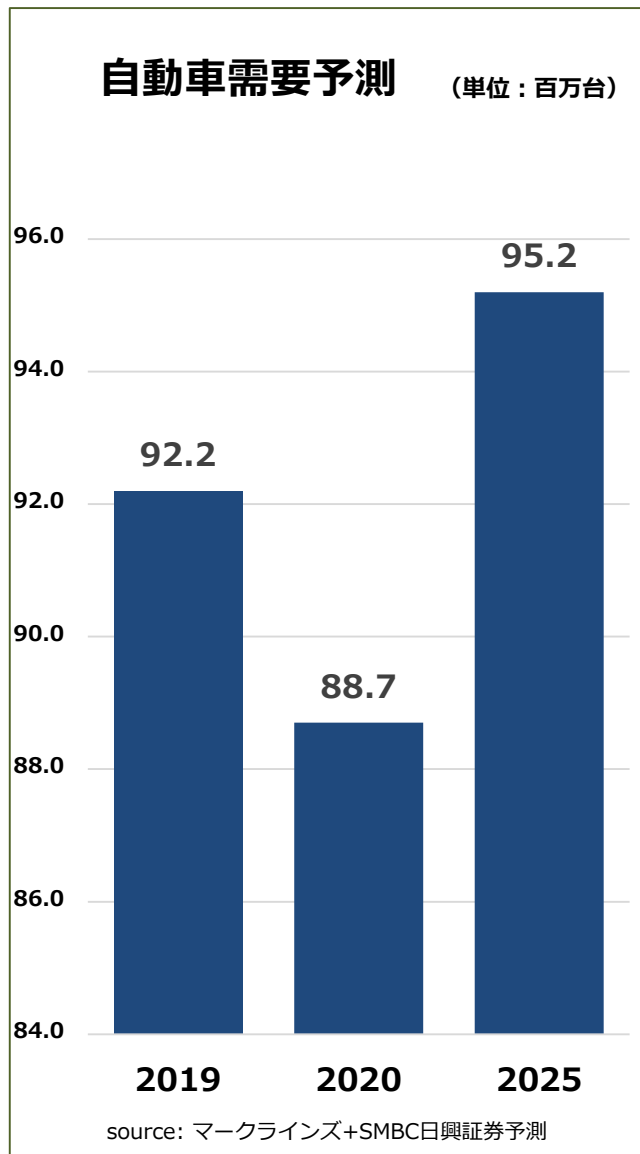
2

今後の方針

3

技術ロードマップ

グローバル市場需要予測



今後の方針

売上高の拡大

- 車載先端分野
- スマホ先端分野
- 5G・モジュール分野
- EMS事業

営業利益率の向上

- 先端分野の比率を高める
- 生産性の改善
- 固定費販管費削減
- 日本国内売上の利益向上

財務戦略

- コミットメントライン300億円
期間5年の締結
- 有利子負債削減
- 自己資本比率の向上
- ROICの向上

投資戦略

- 5G・モジュール分野
- 車載先端分野
- 省人化投資

設備投資

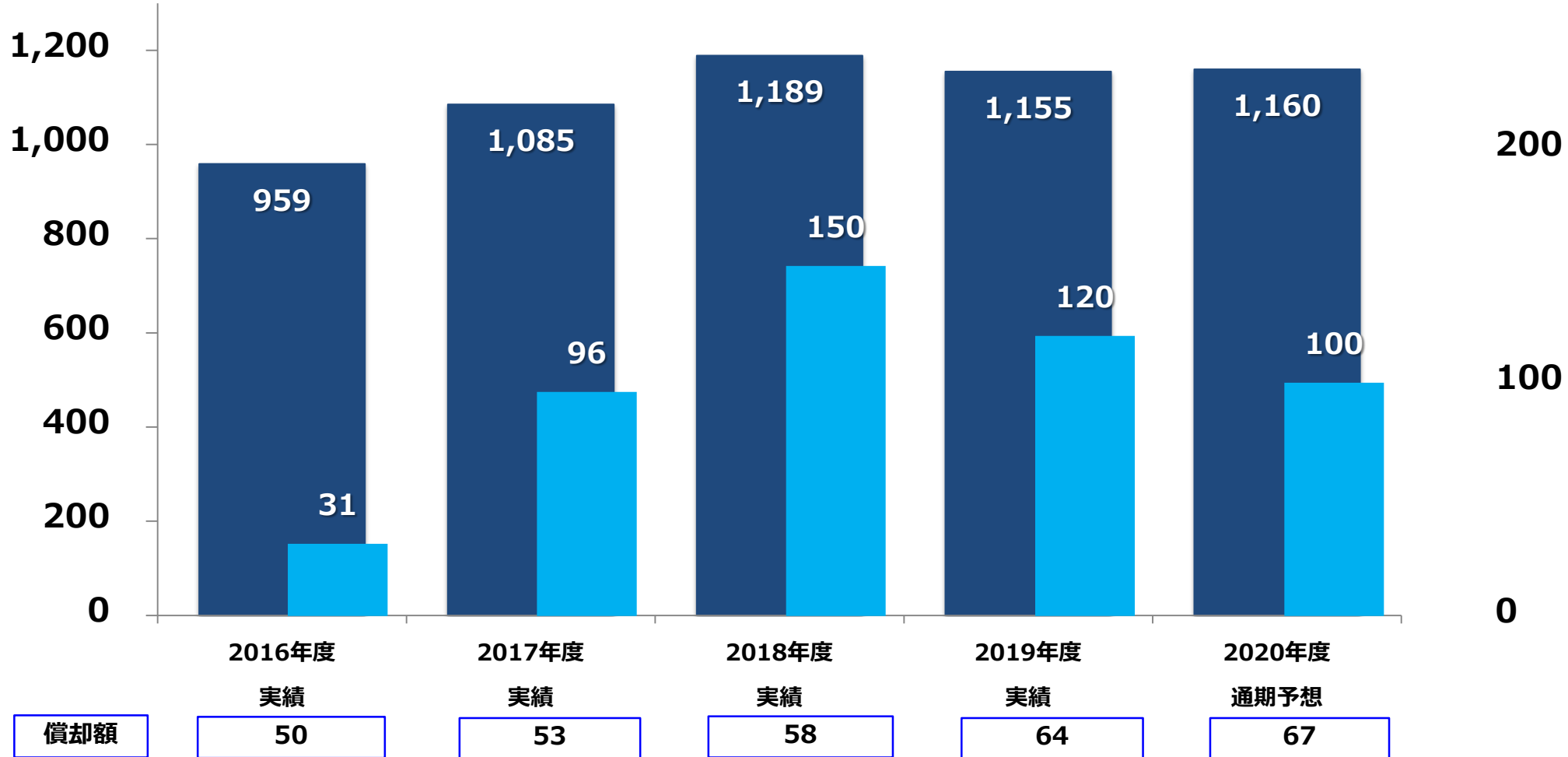
戦略投資分野 → 車載・スマホ先端分野・5G/モジュール分野

売上高
(億円)

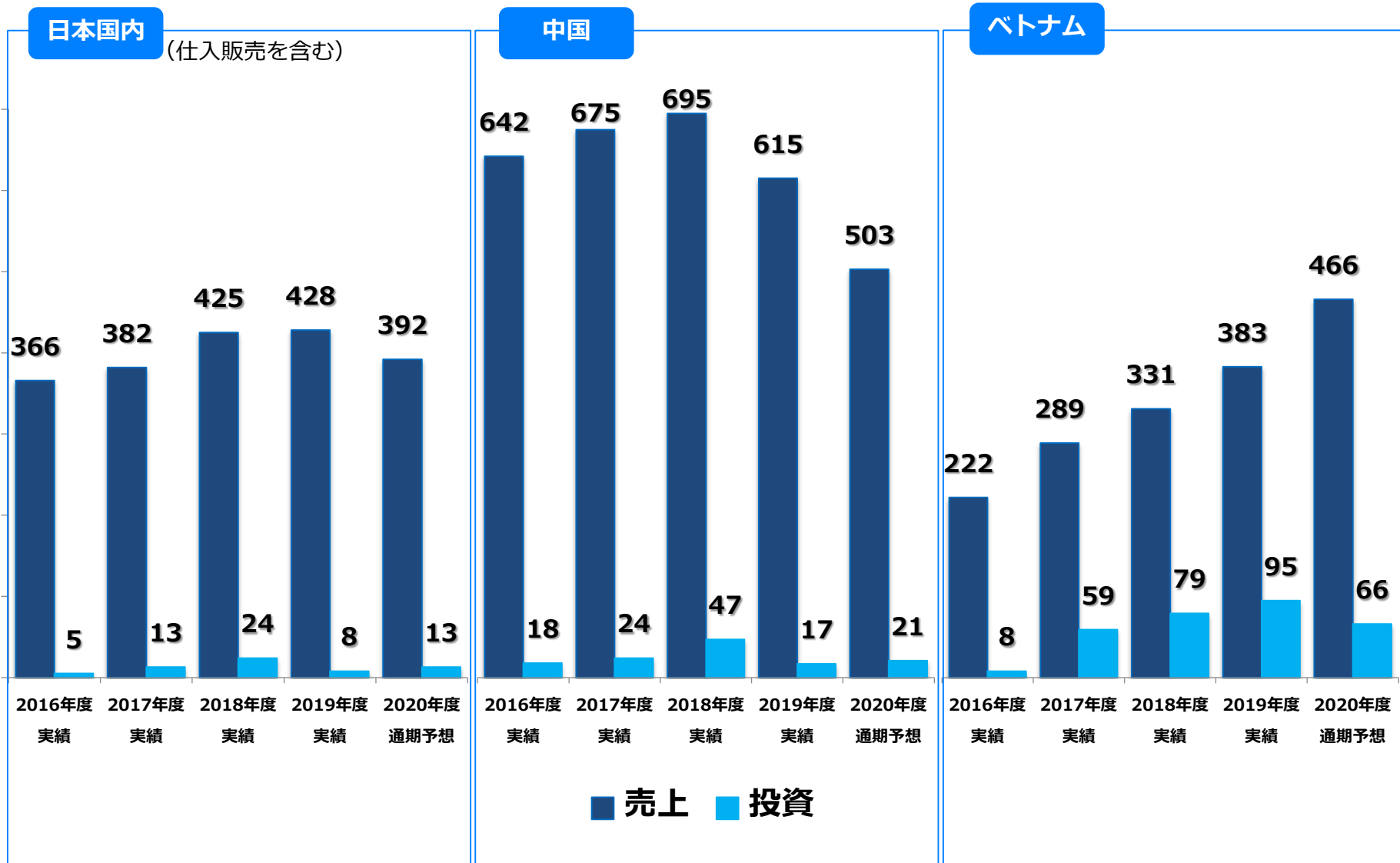
投資額
(億円)

売上

投資

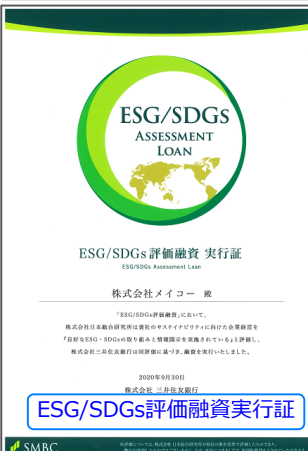


国別売上と設備投資の推移



今後の方針 ESG経営

取組項目	
E	二酸化炭素排出量
	水の再利用
	資源リサイクル
S	社会・地域貢献
	女性活躍 多様性
G	ガバナンス強化



ESG取組みの可視化推進

- ・ホームページでの情報発信強化
- ・統合報告書発行

1

上期実績/下期予想

2

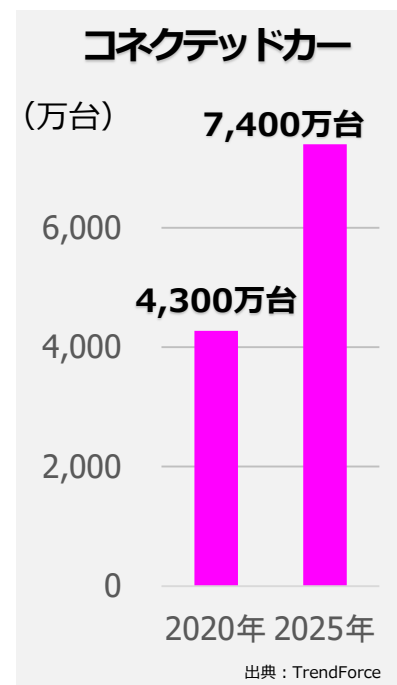
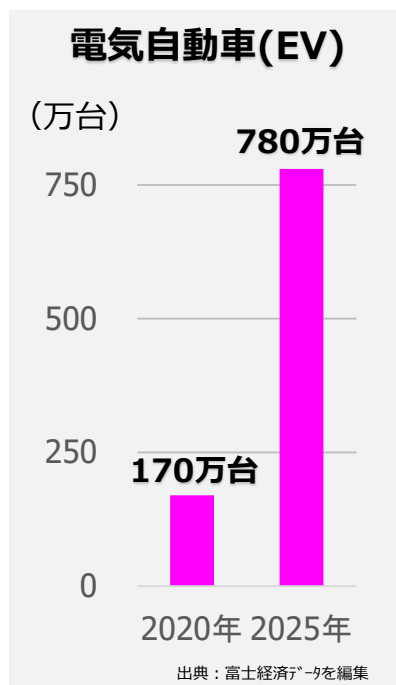
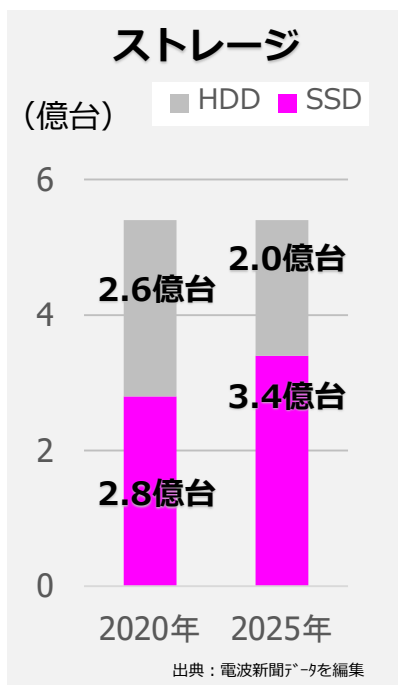
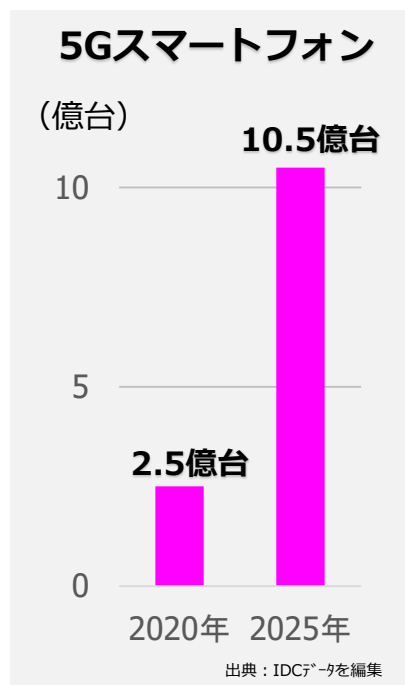
今後の方針

3

技術ロードマップ

主な市場の中期見通し

世界の産業動向は、社会および経済活動の不可逆的変化により
サイバー空間を通じた価値の提供が増え、リアル空間の価値が量から質へ変化する

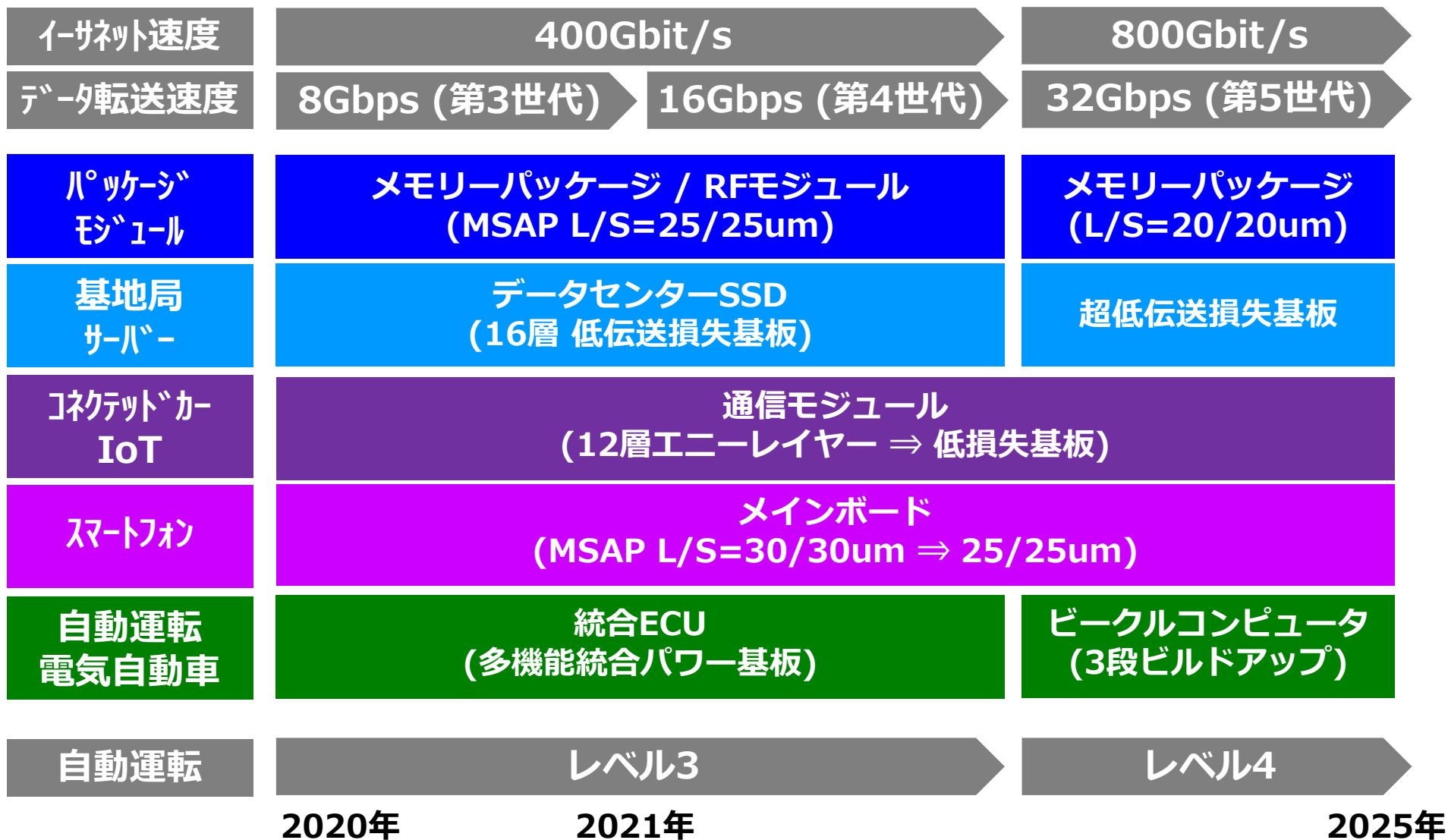


- 5Gスマートフォンが成長、ビッグデータ量の増加によりSSDが成長
- 環境や自動運転への意識の高まりから、電気自動車やコネクテッドカーが成長
- 高速伝送対応の高密度ビルドアップ基板や多機能な車載基板の需要が拡大

5 G分野のプリント配線板

分野	製品	用途	生産工場	進捗	特徴	構造
スマートフォン		メイン基板	武漢工場 越南工場	量産	高速伝送対応 狭ピッチ配線	10層エーレイヤ-基板 12層エーレイヤ-基板
		RF モジュール	越南工場	量産	薄型 小径ビア配線	8層エーレイヤ-基板
IoT		通信 モジュール	武漢工場	量産	高速伝送対応 実装信頼性	12層エーレイヤ-基板
コネクタ カー		通信 モジュール	越南工場 石巻工場	試作	高速伝送対応 実装信頼性	12層エーレイヤ-基板 12層ビルトアップ [®] 基板
サーバー ストレージ		SSD	武漢工場	試作	高速伝送対応 ハイブリッド [®] 構造	16層ビルトアップ [®] 基板
		メモリー パッケージ	越南工場	試作	薄型 狭ピッチ配線	3層エーレイヤ-基板 4層エーレイヤ-基板

技術開発ロードマップ



自動車ECUの統合化に向けた開発事例

多機能統合パワー基板 Multi-function Integrated Power PWB

大電流・放熱・3D実装(小型化)の機能を組み合わせたパワー基板

Power PWB with Combination of Larger Current, Heat Dissipation, 3D-Assembly and Miniaturization

大電流

Larger Current

厚銅基板

Heavy-Cu PWB

パワーデバイス・大電流ユニットに対応
Use for Power Device & Larger Current Unit



厚銅基板断面
X-section of Heavy-Cu PWB

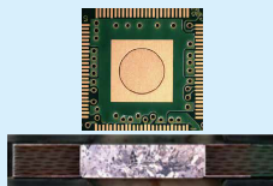
放熱

Heat Dissipation

銅インレイ基板

Cu-Inlay PWB

素子からヒートシンクへ放熱
Heat Dissipation from FET to Heat Sink



銅インレイ基板断面
X-section of Cu-Inlay PWB

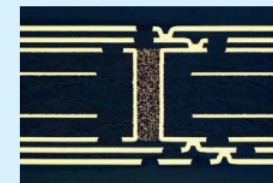
小型化

Miniaturization

車載ビルドアップ基板

Automotive HDI PWB

レーザービアによる高密度配線
High-Density Wiring by Using Microvia



ビルドアップ基板断面
X-section of HDI PWB

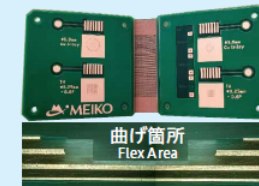
3D実装

3D-Assembly

FR4-Flex基板

Semi-flex PWB

小型・省スペースに組み込み
Assembly Into a Limited Space



FR4-Flex基板断面
X-section of Semi-flex PWB

